## 作品名称

队伍名；姓名1；姓名2；姓名3；指导老师

（不要出现任何涉及学校名称等内容）

**摘要**

800字内

**第一部分 作品概述**

* 1. 功能与特性

400字内（可加重要图）；

* 1. 应用领域

400字内（可加重要图）；

* 1. 主要技术特点

400字内；

* 1. 主要性能指标

200字内（建议用表格）；

* 1. 主要创新点

200字以内（逐点给出）；

* 1. 设计流程

200字内（可加重要图）；

**第二部分 系统组成及功能说明**

阐述具体的设计细节（图文结合）

* 1. 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

* 1. 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

2.2.2 机械设计介绍（如果有的话，从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，可以是CAD文件截图或者手绘图片）；

2.2.3 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，可以是电路图、SCH原理图、PCB版图等截图）；

* 1. 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含PC端或云端，结合关键图片）；

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

**第三部分 完成情况及性能参数**

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

* 1. 整体介绍（整个系统实物的正面、斜45°全局性照片）
  2. 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（实物照片）

3.2.2 电路成果；（实物照片）

3.2.3 软件成果；（界面照片）

* 1. 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

**第四部分 总结**

* 1. 可扩展之处

300字内；

* 1. 心得体会

1000字内，可包括研发和制作细节；

**第五部分 参考文献**

按照标准格式，限20篇以内。